



2022年8月4日

各位

上場会社名 昭和電工株式会社  
コード番号 4004 東証プライム市場  
代表者名 代表取締役社長 高橋 秀仁  
問合せ先 ブランド・コミュニケーション部長 山田 亜紀子  
TEL (03) 5470 - 3235

## 持株会社体制への移行に伴う吸収合併および吸収分割 ならびに商号および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年3月9日付「持株会社体制への移行の検討開始について」（以下「本持株会社化適時開示文書」）および「統合新会社の商号決定に関するお知らせ」（以下「本商号変更適時開示文書」）において公表した内容にもとづき、本日開催した取締役会において、持株会社体制への移行のための吸収合併および吸収分割に関する契約の締結ならびに商号の変更およびこれに伴う定款の一部変更に関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本持株会社化実施のために締結した契約は、(i) 当社の完全子会社であるHCホールディングス株式会社（以下「HCHD」）を吸収合併消滅会社とし、HCHDの完全子会社である昭和電工マテリアルズ株式会社（以下「SDMC」）を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」）に関する、HCHDとSDMCとの間での吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」）、(ii) 当社を吸収分割会社とし、SDMCを吸収分割承継会社としてSDMCに当社の全事業を承継させる会社分割（以下「本吸収分割①」）に関する、当社とSDMCとの間での吸収分割契約（以下「本吸収分割契約①」）、および(iii) SDMCを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社として一部機能を当社に承継させる会社分割（以下「本吸収分割②」）とし、本吸収分割①と本吸収分割②を併せて「本吸収分割」に関する、当社とSDMCとの間での吸収分割契約（以下「本吸収分割契約②」）、の3件であり、いずれも2023年1月1日（予定）を効力発生日としております。本持株会社化の詳細については、本持株会社化適時開示文書をご参照ください。

また当社は、本持株会社化が決定した場合、当社およびSDMCの商号を変更いたします。このため当社は本日開催の取締役会において、本吸収合併および本吸収分割の効力発生日（以下「本効力発生日」）付で当社の商号および目的を変更する旨の定款の一部変更につき、2022年9月29日に開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）に付議することを決議いたしました。本商号変更の詳細については、本商号変更適時開示文書をご参照ください。

なお本吸収合併および本吸収分割は、当社と当社の完全子会社であるHCHDおよび完全孫会社であるSDMCとの間で行う行為であることから、開示事項および内容を一部省略しております。

記

## I. 本吸収合併について

### 1. 本吸収合併の目的

当社グループは「化学の力で社会を変える」をパーパス（存在意義）とし、共創型化学会社として「日本発の世界トップクラスの機能性化学メーカー」を目指しております。当社グループはこうした目指す姿のもと、社内や化学産業に閉じた事業活動にとどまらず、志を共にするステークホルダーや共同体との共創を通じてよりよい社会を創り出し、持続可能なグローバル社会の発展に貢献することを目指し変革を進めております。

また当社グループは、世界で戦える会社の前提となる規模と収益性を実現するため、メリハリある経営資源配分によるポートフォリオ経営、競争力を生み出すイノベーションおよび人材育成戦略に注力いたし、こうした取り組みを通じて企業価値を最大化し、持続的な経営を実現してまいります。そのための最適な組織体制を構築するため、本吸収合併および本吸収分割を行います。

### 2. 本吸収合併の要旨

#### (1) 本吸収合併の日程（予定）

当社およびSDMCにおける本吸収合併契約承認取締役会	2022年8月4日（本日）
HCHDにおける本吸収合併契約承認取締役決定	2022年8月4日（本日）
本吸収合併契約締結	2022年8月4日（本日）
HCHDおよびSDMCにおける臨時株主総会決議日	2022年9月29日（予定）
本吸収合併効力発生日	2023年1月1日（予定）

#### (2) 本吸収合併の方式

HCHDの完全子会社であるSDMCを吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社であるHCHDを吸収合併消滅会社とする吸収合併です。本吸収合併については、SDMCおよびHCHDの株主総会において承認を受けた上で、2023年1月1日を効力発生日として実施される予定です。

なお、本吸収分割①が付議された株主総会において本吸収分割①の承認が得られない場合には、本吸収合併については実行いたしません。

#### (3) 本吸収合併に係る割当ての内容

本吸収合併に際して吸収合併存続会社であるSDMCは、普通株式6株を発行し、そのうち、HCHDの普通株式に代わる金銭等として当社の保有するHCHDの普通株式295,000,000,001株につきSDMC普通株式3株を、HCHDのA種優先株式に代わる金銭等として当社の保有するHCHDのA種優先株式275,000,000,000株につきSDMC普通株式3株を、それぞれ当社に割当交付いたします。

#### (4) 本吸収合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### 3. 本吸収合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	昭和電工マテリアルズ株式会社	HCホールディングス株式会社
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号	東京都港区芝大門一丁目13番9号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 高橋 秀仁	代表取締役 仁井 裕之
(4) 事業内容	機能材料および先端部品・システムの製造・加工・サービスの提供および販売	株式を所有することにより、SDMCの事業活動の支配および管理を行うこと
(5) 資本金	15,454,363,445 円	100,000,000 円
(6) 設立年月日	1962年10月10日	2019年12月9日
(7) 発行済株式数	8株	普通株式 295,000,000,001株 A種優先株式 275,000,000,000株 合計 570,000,000,001株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主および持株比率	HCホールディングス株式会社 (100%)	当社 (100%)
(10) 直近事業年度の経営成績および財政状態		
	SDMC (存続会社)	
	2021年12月期	
決算期		
連結純資産	446,075 百万円	
連結総資産	689,953 百万円	
1株当たり連結純資産	54,612,875,000.00 円	
連結売上高	635,033 百万円	
連結営業利益	24,295 百万円	
連結税引前当期利益	31,272 百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	19,316 百万円	
1株当たり連結当期純利益	2,414,500,000.00 円	
1株当たり配当金	2,375,000,000 円	
	HCHD (消滅会社)	
	2021年12月期	
決算期		
純資産	584,249 百万円	
総資産	984,514 百万円	
1株当たり純資産	1.02 円	
売上高	19,000 百万円	
営業利益	19,000 百万円	
経営利益	13,135 百万円	
当期純利益	13,136 百万円	
1株当たり当期純利益	0.02 円	
1株当たり配当金	0.02 円	

#### 4. 本吸収合併後の状況

本吸収合併後の吸収合併存続会社であるSDMCの概要は以下のとおりです。

(1) 名 称	株式会社レゾナック
(2) 所 在 地	東京都港区芝大門一丁目 13 番 9 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 高橋 秀仁
(4) 事 業 内 容	各種機能材料および化学品、その加工品ならびにシステムの研究・開発・製造・販売・サービスの提供
(5) 資 本 金	15,554,363,445 円
(6) 決 算 期	12 月 31 日

(注1) SDMCは、2023年1月1日に、本吸収合併および本吸収分割の効力が発生することを条件として、その商号を「株式会社レゾナック」に変更する予定です。

(注2) SDMCは、2023年1月1日に、その本社所在地を東京都千代田区から当社と同じ東京都港区に変更する予定です。

#### 5. 今後の見通し

本吸収合併は、完全親子会社間の吸収合併であるため、連結業績に与える影響は特段ございません。

### II. 本吸収分割について

#### 1. 本吸収分割の目的

本吸収分割は、本持株会社化の一環として行われるものです。本持株会社化の目的・意義については、上記I. 1.をご参照ください。

#### 2. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程 (予定)

当社の臨時株主総会基準日	2022年6月30日
当社およびSDMCにおける本吸収分割契約承認取締役会	2022年8月4日(本日)
本吸収分割契約①および本吸収分割契約②締結	2022年8月4日(本日)
当社およびSDMCにおける本吸収分割①を承認する臨時株主総会決議日	2022年9月29日(予定)
本吸収分割効力発生日	2023年1月1日(予定)

(注) 本吸収分割②は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易吸収分割の要件を満たし、またSDMCにおいては会社法第784条第1項に規定する略式吸収分割の要件を満たすため、当社およびSDMCの株主総会の承認を経ずに本吸収分割②を行います。

##### (2) 本吸収分割の方式

本吸収分割①は、当社を吸収分割会社とし、本日時点で当社の完全孫会社であり、本吸収合併の効力発生日後に当社の完全子会社となるSDMCを吸収分割承継会社とする吸収分割です。本吸収分割②は、本日時点で当社の完全孫会社であり、本吸収合併の効力発生日後に当社の完全子会社となるSDMCを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

本吸収分割①については、当社およびSDMCの株主総会において承認を受けた上で、2023年1月1日を効力発生日として実施される予定です。

なお、本吸収分割①の効力発生については、本吸収合併の効力発生および当社と当社の完全子会社である信州昭和株式会社との間の2022年8月4日付吸収分割契約書に基づく吸収分割（以下「本吸収分割（信州）」）の効力発生が条件となります。ただし、本吸収分割（信州）の効力が2023年1月1日に発生しない場合には、本吸収分割①の効力発生については、本吸収合併の効力発生のみが条件となります。本吸収分割（信州）の詳細については、本日同時に開示した「会社分割（簡易分割）による黒鉛電極事業の承継に関するお知らせ」をご参照ください。

本吸収分割②の効力発生については、本吸収合併および本吸収分割①の効力発生が条件となります。

また、株主総会において本吸収分割①の承認が得られない場合には、本吸収分割②については実行いたしません。

### （3）本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割①に際し、吸収分割承継会社であるSDMCは、普通株式4株を発行し、そのすべてを吸収分割会社である当社に割当交付いたします。

本吸収分割②に際し、吸収分割承継会社である当社は、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

### （4）本吸収分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

### （5）本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割に伴う当社の資本金の増減はありません。

### （6）承継会社が承継する権利義務

本吸収分割①により、SDMCが当社から承継する権利義務は、当社のグループ経営管理および本吸収分割（信州）の効力が発生した場合における当社から信州昭和株式会社に承継される黒鉛電極事業に係る権利義務を除くすべての事業（本吸収分割①に係る契約の締結時点において営む事業および当該時点以前において営んでいた事業を含みます。）に関して有する資産、負債、契約その他の権利義務（契約上の地位を含みます。）のうち、本吸収分割契約①に規定されるものといたします。

なお、債務の承継については、重畳的債務引受の方法によるものとします。

本吸収分割②により、当社がSDMCから承継する権利義務は、SDMCの有する資産および負債のうち、本吸収分割契約②に規定されるものといたします。

なお、債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとします。

### （7）債務履行の見込み

本吸収分割後、当社およびSDMCの資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれており、また、本吸収分割後の収益見込みについても、当社またはSDMCが負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていません。

以上より、本吸収分割後においても、当社およびSDMCの債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

## 3. 本吸収分割の当事会社の概要

## (1) 本吸収分割①

	分割会社	承継会社	
(1) 名称	昭和電工株式会社	昭和電工マテリアルズ株式会社	
(2) 所在地	東京都港区芝大門一丁目13番9号	東京都千代田区丸の内一丁目9番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 秀仁	代表取締役 高橋 秀仁	
(4) 事業内容	石油化学、有機・無機化学品、ガス、セラミックス、電子材料、アルミニウム、炭素、金属などの研究・開発・製造・販売	機能材料および先端部品・システムの製造・加工・サービスの提供および販売	
(5) 資本金	182,146,130,384円	15,454,363,445円	
(6) 設立年月日	1939年6月1日	1962年10月10日	
(7) 発行済株式数	184,901,292株	8株	
(8) 決算期	12月31日	12月31日	
(9) 大株主および持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (16.38%) KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG (5.00%) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) (4.89%) BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (3.06%) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (2.70%)	HCホールディングス株式会社 (100%) (注)	
(10) 最近3年間の経営成績および財政状態			
決算期	当社(分割会社)		
	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
連結純資産	519,433百万円	718,080百万円	818,452百万円
連結総資産	1,076,381百万円	2,203,606百万円	2,142,390百万円
1株当たり連結純資産	3,423.25円	2,782.79円	2,838.51円
連結売上高	906,454百万円	973,700百万円	1,419,635百万円
連結営業利益	120,798百万円	△19,449百万円	87,198百万円
連結経常利益	119,293百万円	△43,971百万円	86,861百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	73,088百万円	△76,304百万円	△12,094百万円
1株当たり連結当期純利益	501.03円	△523.06円	△77.40円
1株当たり配当金	130円	65円	65円
決算期	S DMC(分割承継会社)		
	2020年3月期	2020年12月期	2021年12月期
連結純資産	432,614百万円	416,413百万円	446,075百万円
連結総資産	704,425百万円	670,204百万円	689,953百万円
1株当たり連結純資産	52,929,000,000.00円	51,005,875,000.00円	54,612,875,000.00円
連結売上高	631,433百万円	429,238百万円	635,033百万円
連結営業利益	23,126百万円	12,510百万円	24,295百万円
税引前当期利益	23,960百万円	14,821百万円	31,272百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	16,401百万円	7,321百万円	19,316百万円
1株当たり連結当期純利益	2,050,125,000.00円	915,125,000.00円	2,414,500,000.00円
1株当たり配当金	30.00円	3,750,000,000円	2,375,000,000円

(注1) HCHDは2023年1月1日付で本吸収合併により解散する予定であるため、本吸収合併の効力発生後におけるSDMCの大株主および持株比率は「当社(100%)」となります。

(注2) 当社は、SDMCを当社の連結子会社とし、2020年第3四半期以降においてSDMCの売上高および損益を取り込んでおります。

(注3) SDMCは2020年12月期より決算月を12月へ変更している為、2020年12月期は、9ヶ月間の実績数値となっております。

(2) 本吸収分割②

		分割会社	承継会社
(1) 名 称		昭和電工マテリアルズ株式会社	昭和電工株式会社
(2) 所 在 地		東京都千代田区丸の内一丁目9番2号	東京都港区芝大門一丁目13番9号
(3) 代表者の役職・氏名		代表取締役 高橋 秀仁	代表取締役社長 高橋 秀仁
(4) 事 業 内 容		機能材料および先端部品・システムの製造・加工・サービスの提供および販売	石油化学、有機・無機化学品、ガス、セラミックス、電子材料、アルミニウム、炭素、金属などの研究・開発・製造・販売
(5) 資 本 金		15,454,363,445 円	182,146,130,384 円
(6) 設 立 年 月 日		1962年10月10日	1939年6月1日
(7) 発 行 済 株 式 数		8 株	184,901,292 株
(8) 決 算 期		12月31日	12月31日
(9) 大株主および持株比率		H Cホールディングス株式会社 (100%) (注)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (16.38%) KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG (5.00%) 株式会社日本カストディ銀行(信託口) (4.89%) BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (3.06%) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 (2.70%)
(10) 当事会社間の関係等	資本関係	当社は、本吸収分割②の効力発生時点において、SDMCの発行済株式総数の100%を保有しており、親会社であります。	
	人的関係	当社の取締役3名がSDMCの取締役を兼務しております。	
	取引関係	当社は、SDMCに製品を販売しており、またSDMCから原材料を購入しております。	
	関連当事者への該当状況	SDMCは、当社の連結子会社であり、当社とSDMCは相互に関連当事者に該当いたします。	
(11) 最近3年間の経営成績および財政状態			
決 算 期	SDMC (分割会社)		
	2020年3月期	2020年12月期	2021年12月期
連 結 純 資 産	432,614 百万円	416,413 百万円	446,075 百万円
連 結 総 資 産	704,425 百万円	670,204 百万円	689,953 百万円
1 株 当 たり 連 結 純 資 産	52,929,000,000.00 円	51,005,875,000.00 円	54,612,875,000.00 円
連 結 売 上 高	631,433 百万円	429,238 百万円	635,033 百万円
連 結 営 業 利 益	23,126 百万円	12,510 百万円	24,295 百万円
税 引 前 当 期 利 益	23,960 百万円	14,821 百万円	31,272 百万円
親会社株主に帰属する	16,401 百万円	7,321 百万円	19,316 百万円

当期純利益			
1株当たり連結当期純利益	2,050,125,000.00円	915,125,000.00円	2,414,500,000.00円
1株当たり配当金	30.00円	3,750,000,000円	2,375,000,000円
決算期	当社（分割承継会社）		
	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
連結純資産	519,433百万円	718,080百万円	818,452百万円
連結総資産	1,076,381百万円	2,203,606百万円	2,142,390百万円
1株当たり連結純資産	3,423.25円	2,782.79円	2,838.51円
連結売上高	906,454百万円	973,700百万円	1,419,635百万円
連結営業利益	120,798百万円	△19,449百万円	87,198百万円
連結経常利益	119,293百万円	△43,971百万円	86,861百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	73,088百万円	△76,304百万円	△12,094百万円
1株当たり連結当期純利益	501.03円	△523.06円	△77.40円
1株当たり配当金	130円	65円	65円

(注1) HCHDは2023年1月1日付で本吸収合併により解散する予定であるため、本吸収合併の効力発生後におけるSDMCの大株主および持株比率は「当社（100%）」となります。

(注2) SDMCは2020年12月期より決算月を12月へ変更している為、2020年12月期は、9ヶ月間の実績数値となっております。

(注3) 当社は、SDMCを当社の連結子会社とし、2020年第3四半期以降のSDMCの売上高および損益を取り込んでおります。

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 本吸収分割①

##### (i) 分割する部門の事業内容

当社が営むすべての事業（但し、グループ経営管理および本吸収分割（信州）の効力が発生した場合における当社から信州昭和株式会社へ承継される黒鉛電極事業に係る権利義務を除く。）

##### (ii) 分割する部門の経営成績（2021年12月期）（単位：百万円）

	承継対象事業 (a)	分割会社単体 (b)	比率 (a/b)
売上高	535,649	535,649	100%
営業利益	35,848	35,848	100%
経常利益	49,314	49,314	100%

##### (iii) 分割する資産、負債の項目および金額（2021年12月31日現在）（単位：百万円）

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	295,828	流動負債	128,295
固定資産	276,360	固定負債	11,538
合計	572,188	合計	139,833

(注) 上記金額は2021年12月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際の金額は、上記金額に効力発生日までの増減を加除した金額となります。



(2) 本吸収分割②

(i) 分割する部門の事業内容

事業を承継するものではありません。

(ii) 分割する部門の経営成績 (2021年12月期)

該当する事業がございません。

(iii) 分割する資産、負債の項目および金額 (2021年12月31日現在) (単位: 百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	27,551	流動負債	7,551
固定資産	0	固定負債	20,000
合計	27,551	合計	27,551

(注) 上記金額は2021年12月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際の金額は、上記金額に効力発生日までの増減を加除した金額となります。

5. 本吸収分割後の状況

本吸収分割後の分割会社である当社の概要については、上記3.「本吸収分割の当事会社の概要」をご参照ください。

本吸収分割後の承継会社の概要は以下のとおりです。

	当社	S DMC
(1) 名称	株式会社レゾナック・ホールディングス	株式会社レゾナック
(2) 所在地	東京都港区芝大門一丁目13番9号	東京都港区芝大門一丁目13番9号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 高橋 秀仁	代表取締役 高橋 秀仁
(4) 事業内容	グループ戦略立案およびグループ全体の統括管理	各種機能材料および化学品、その加工品ならびにシステムの研究・開発・製造・販売・サービスの提供
(5) 資本金	182,146,130,384円	15,554,363,445円
(6) 決算期	12月31日	12月31日

(注1) 当社は、2023年1月1日に、本吸収合併および本吸収分割の効力が発生することを条件として、その商号を「株式会社レゾナック・ホールディングス」に変更する予定です。

(注2) S DMCは、2023年1月1日に、本吸収合併および本吸収分割の効力が発生することを条件として、その商号を「株式会社レゾナック」に変更する予定です。

(注3) S DMCは、2023年1月1日に、その本社所在地を東京都千代田区から当社と同じ東京都港区に変更する予定です。

6. 会計処理の概要

本吸収分割②については、その効力発生時点においては、完全親子会社間の取引となる予定であるため、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)および「企業結合会計基準および事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)における共通支配下の取引に該当し、のれん(または負ののれん)は発生しない見込みです。

## 7. 今後の見通し

本吸収分割は、完全親子会社間の吸収分割であるため、連結業績に与える影響は特段ございません。

## III. 商号変更について

### 1. 変更の理由

当社およびSDMCは、本商号変更適時開示文書にて公表いたしましたとおり、本持株会社化に際し、本吸収合併および本吸収分割により持株会社体制に移行することに伴い、本吸収合併および本吸収分割の効力が発生することを条件として、本効力発生日付で、商号を変更いたします。

### 2. 新商号

当社 株式会社レゾナック・ホールディングス（英文表記：Resonac Holdings Corporation）  
SDMC 株式会社レゾナック（英文表記：Resonac Corporation）

### 3. 変更予定日

2023年1月1日

## IV. 定款の一部変更について

### 1. 定款変更の理由

#### ①商号および目的の変更（第1条および第3条）

当社は、本持株会社化適時開示文書にて公表いたしましたとおり、本吸収合併および本吸収分割により持株会社体制に移行することを予定しております。これに伴い、当社の商号を「株式会社レゾナック・ホールディングス」に変更するとともに、当社の目的を持株会社に変更し、また、持株会社の下の子会社の目的を当社及びSDMCの両事業を統合したものにする定款変更を行います。

なお、商号および目的に係る変更は、本吸収合併および本吸収分割の効力発生を条件として、その効力発生日である2023年1月1日付で生じるものとし、その旨の附則を設けます。

#### ②取締役および監査役の員数上限の追加（第18条および第29条）

取締役会および監査役会の適正な規模および機能を保つため、取締役の員数の上限を12名、監査役の員数の上限を6名と定める規定を追加します。

### 2. 定款変更の内容

（下線部分は変更部分であります。）

現行定款	変更案
（商号） 第1条 当社は、 <u>昭和電工株式会社（英文で表す場合は、Showa Denko K. K.）</u> と称する。	（商号） 第1条 当社は、 <u>株式会社レゾナック・ホールディングス（英文で表す場合は、Resonac Holdings Corporation）</u> と称する。
（目的） 第3条 当社は、 <u>次の事業を営むこと</u> を目的とする。	（目的） 第3条 当社は、 <u>次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の経営管理を行う</u>

<p>1. 次の製品の製造、売買および輸出入</p> <p>(1) <u>合成樹脂、合成ゴム、合成繊維その他高分子製品およびこれらの原料</u></p> <p>(2) <u>無機および有機工業薬品ならびにガス製品</u></p> <p>(3) <u>化学肥料、農薬ならびに飼料および飼料添加物</u></p> <p>(4) <u>医薬品、医薬部外品、動物用医薬品および医療機器</u></p> <p>(5) <u>食品、食品添加物、酵素類およびアミノ酸類</u></p> <p>(6) <u>半導体その他電子工業材料</u></p> <p>(7) <u>軽金属、合金鉄その他各種金属およびその合金類</u></p> <p>(8) <u>炭素製品、研削材、耐火材その他セラミックス</u> (新設)</p> <p>(9) <u>土木建築用資材、住宅用資材および農業用資材</u></p> <p>(10) <u>化学工業用、エネルギー産業用、環境保全用その他各種設備、システム、機器および精密機器</u></p> <p>(11) <u>前記各製品の加工品および関連品</u></p> <p>2. ～5. (条文省略)</p> <p>6. <u>建設工事</u></p> <p>7. ～10. (条文省略)</p> <p>11. <u>前各号に関連する設計および技術指導</u></p> <p>12. (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第18条～第27条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第28条～第41条 (条文省略)</p>	<p>ことを目的とする。</p> <p>1. 次の製品の製造、売買および輸出入</p> <p>(1) <u>半導体・電子材料および記録メディアその他の電子部品・デバイス・電子回路</u></p> <p>(2) <u>有機化学工業製品、無機化学工業製品、医薬品、産業ガス、化学肥料、農薬その他の化学工業製品</u></p> <p>(3) <u>プラスチック製品</u></p> <p>(4) <u>非鉄金属および金属製品</u></p> <p>(5) <u>電気機械器具</u></p> <p>(6) <u>食品添加物、酵素類、アミノ酸類その他の食料品ならびに飼料および飼料添加物</u></p> <p>(7) <u>炭素・黒鉛製品その他の窯業・土石製品</u></p> <p>(8) <u>再生医療等製品その他の医薬関連製品</u></p> <p>(9) <u>医療機器その他の業務用機械器具</u></p> <p>(10) <u>土木建築用資材、住宅用資材および農業用資材</u></p> <p>(11) <u>産業用および環境保全用その他各種設備、システム、機器および精密機器</u></p> <p>(12) <u>前記各製品の加工品、応用製品および関連品</u></p> <p>2. ～5. (現行どおり)</p> <p>6. <u>電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事、土木工事、鋼構造物工事、その他建設工事の設計、施工、監理および請負</u></p> <p>7. ～10. (現行どおり)</p> <p>11. <u>前各号に関連する設計および技術指導その他の役務提供</u></p> <p>12. (現行どおり)</p> <p>② <u>当社は、前項に附帯または関連する一切の事業を営むことができる。</u></p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 <u>当社の取締役は、12名以内とする。</u></p> <p>第19条～第28条 (現行どおり)</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第29条 <u>当社の監査役は、6名以内とする。</u></p> <p>第30条～第43条 (現行どおり)</p>
---	---

(新設)	<u>附則</u> <u>第1条および第3条の変更は、2023年1月1日に効力が生じるものとする。なお、本附則は、当該効力発生後、これを削除する。</u>
------	--

### 3. 定款変更の日程

定款変更を付議する臨時株主総会開催日	2022年9月29日(予定)
定款変更(第18条以降関係)の効力発生日	2022年9月29日(予定)
定款変更(第1条および第3条関係)の効力発生日	2023年1月1日(予定)

以上